

聯系:

投資人關係
+86-21-2081-2804
ir@smics.com

新聞稿

中芯國際二零一三年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本合併財務報告係依國際財務報告準則編製。

中國上海 — 2014年2月17日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一三年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一三年第四季摘要

- 包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第四季銷售額為肆億玖仟壹佰捌拾萬元，與二零一二年第四季相比增加 1.2%，與二零一三年第三季相比下降 7.9%。
- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第四季非公認準則的銷售額為肆億捌仟參佰陸拾萬元，與二零一二年第四季相比增加 10.6%，與二零一三年第三季相比下降 4.0%。
- 包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第四季毛利率為 18.9%，相比二零一二年第四季為 19.9%，二零一三年第三季為 21.0%。
- 不包括來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第四季非公認準則的毛利率為 19.2%，相比二零一二年第四季為 21.9%，二零一三年第三季為 22.1%。

二零一四年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 季度收入預期下降 5%至下降 9%[4 億 4 仟萬元至 4 億 6 仟萬元]，這收入的指引與二零一三年第四季不含來自武漢新芯銷售額的收入相關。自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的銷售額。
- 毛利率預期在 16%至 19%範圍內。

-
- 非公認準則的經營開支為扣除匯兌損益、雇員花紅計提數、在研究發展的合約上獲得政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，預期將介於 88 百萬元至 92 百萬元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“對中芯來說，2013 又是破紀錄的一年。根據我們 2013 全年未經審核財務報告，2013 年全年銷售額創新高，達到 20 億 7 千萬元，與 2012 年相比增長 21.6%。如果去掉來自武漢新芯的銷售貢獻，中芯的年銷售額強勁增長，達到了 27%。在 2013 年，中芯國際應佔盈利同樣達到了歷史新高，為 1 億 7 仟 3 佰 20 萬元，而 2012 年中芯國際應佔盈利為 2 仟 2 佰 80 萬元，2013 年相比 2012 年增長了 6.6 倍。截止 2013 年年底我們的月產能為 23 萬 4 千片 8 吋等值晶圓，與 2012 年年底相比同比增長了 6.7%。

我很高興地向大家宣佈，我們的 28 納米高介電常數金屬閘極(HKMG)和 28 納米多晶硅 (PolySiON)工藝定案已成功完成，並且已進入多項目晶圓(MPW)階段。我們預計 28nm 製程在 2014 年底會有少量的銷售貢獻，在 2015 年有明顯的上量。

中國繼續成為中芯高速增長的領頭羊。在 2013 年，來自中國客戶的銷售額約占我們總銷售額的 40.4%，比 2012 年顯著增長 44.9%。

從長期來看，我們對制定的策略滿懷信心，我們有能力抓住成長的機遇，特別是在中國芯片市場。在 2014 年以及未來，我們會繼續和新的及現有的客戶合作，抓住機遇，開拓未來。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一四年二月十八日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 400-620-8038 (密碼：SMIC)

香港 852-2475-0994 (密碼：SMIC)

臺灣 886-2-2650-7825 (密碼：SMIC)

美國 1-845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一三年第四季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

<http://www.media-server.com/m/p/8n4tcoc7>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠。在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立行銷辦事處，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一四年第一季指引”和關於我們預計28nm製程在2014年底會有銷售貢獻，在2015年會有明顯的上量、我們對策略及能力方面有信心去抓住成長的機遇，特別是在中國芯片市場、在2014年以及未來我們預計會抓住機遇以及未來2014年的資本開支等敘述，乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」或類似的用語

來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一三年四月十五日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報(已於二零一三年十二月十九日修改)，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

關於非一般公認會計準則(“非公認準則”)的財務計量

為補充中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此份新聞稿裡使用了營運結果的計量，其調整為不包含來自武漢新芯集成電路製造有限公司(“武漢新芯”)的晶圓轉單(已於二零一三年第三季起逐步結束)。此份業績報告包含非公認準則的收入(非公認準則的銷售額)、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率，亦包含二零一四年第一季財務指引裡的非公認準則的營運開支，其調整為不包含匯兌損益、雇員花紅計提數、在研究發展合約上獲得政府支持的資金以及出售生活園區資產收益的影響。非公認準則的財務計量表達，並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則準備及表達的財務資訊。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務計量，有助於投資者及管理層比較中芯國際過去的業績，本公司管理層規律地使用這些非公認準則財務計量去了解、管理和評估本公司的業務以及去制定財務和營運方面的決策。

後附的表格在每項非公認準則的財務計量及直接可比的公認準則財務計量之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非公認準則計量及公認準則計量之間的調節，在未來的基礎上並不可行。

二零一三年第四季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	季度比較	二零一二年 第四季度	年度比較
收入	491,797	534,256	-7.9%	485,894	1.2%
銷售成本	(398,858)	(422,274)	-5.5%	(389,127)	2.5%
毛利	92,939	111,982	-17.0%	96,767	-4.0%
經營開支	(84,840)	(63,447)	33.7%	(45,079)	88.2%
經營利潤	8,099	48,535	-83.3%	51,688	-84.3%
其他收入(開支)，淨額	7,756	(4,681)	-	(2,591)	-
除稅前利潤	15,855	43,854	-63.8%	49,097	-67.7%
所得稅開支	(170)	(914)	-81.4%	(2,665)	-93.6%
本期利潤	15,685	42,940	-63.5%	46,432	-66.2%
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	333	77	332.5%	(2)	-
本期綜合收入總額	16,018	43,017	-62.8%	46,430	-65.5%
中芯國際應佔利潤	14,681	42,491	-65.4%	46,570	-68.5%
毛利率	18.9%	21.0%	-	19.9%	-
每股普通股股份盈利-基本及攤薄 ⁽¹⁾	0.00	0.00	-	0.00	-
每股美國預托股股份盈利-基本及攤薄	0.02	0.07	-	0.07	-
付運晶圓(約當 8 吋)	601,602	653,090	-7.9%	608,372	-1.1%
產能利用率 ⁽²⁾	87.4%	88.2%	-	90.5%	-

附注：

(1) 基於二零一三年第四季加權平均普通股 321 億零 200 萬股(基本)及 336 億 9 仟 300 萬股(攤薄)，二零一三年第三季 320 億 8 仟 400 萬股(基本)及 323 億 5 仟 500 萬股(攤薄)，二零一二年第四季 319 億 9 仟 700 萬股(基本)及 320 億 4 仟 400 萬股(攤薄)。

(2) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一三年第四季銷售額由二零一三年第三季的 5 億 3 仟 4 佰 30 萬元下降 7.9%至 4 億 9 仟 1 佰 80 萬元，主要由於二零一三年第四季的晶圓付運量減少所致。
- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第四季非公認準則的銷售額為 4 億 8 仟 3 佰 60 萬元，相比二零一三年第三季為 5 億零 3 佰 70 萬元。
- 二零一三年第四季的銷售成本由二零一三年第三季的 4 億 2 仟 2 佰 30 萬元下降 5.5%至 3 億 9 仟 8 佰 90 萬元，主要與銷售額的變動原因相同。
- 二零一三年第四季的毛利由二零一三年第三季的 1 億 1 仟 2 佰萬元減少 17.0%至 9 仟 2 佰 90 萬元。

-
- 二零一三年第四季的毛利率由二零一三年第三季的 21.0% 下降至 18.9%，主要由於本季的產品組合改變、較低的產能利用率及對客戶索賠提列撥備所致。
 - 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第四季非公認準則的毛利率由二零一三年第三季的 22.1% 下降至 19.2%。
 - 二零一三年第四季的經營開支由二零一三年第三季的 6 仟 3 佰 40 萬元增加 33.7% 至 8 仟 4 佰 80 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	二零一二年 第四季度
電腦	1.9%	1.8%	1.0%
通訊	39.8%	44.4%	47.4%
消費	48.3%	43.9%	42.6%
其他	10.0%	9.9%	9.0%
以服務分類	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	二零一二年 第四季度
晶圓	93.2%	93.8%	94.0%
光罩製造，晶圓測試及其它	6.8%	6.2%	6.0%
以客戶類別分類	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	二零一二年 第四季度
無廠房半導體公司	86.7%	87.7%	86.6%
集成裝置製造商	6.0%	5.5%	9.3%
系統公司及其它	7.3%	6.8%	4.1%
以地區分類	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	二零一二年 第四季度
北美洲	48.3%	46.0%	54.4%
中國 ⁽¹⁾	40.0%	42.1%	34.8%
歐亞 ⁽²⁾	11.7%	11.9%	10.8%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	二零一二年 第四季度
40/45 納米	16.3%	15.7%	2.6%
55/65 納米	21.1%	27.1%	35.3%
90 納米	3.5%	4.7%	8.0%
0.13 微米	12.2%	10.1%	10.2%
0.15/0.18 微米	41.5%	38.4%	39.9%
0.25/0.35 微米	5.4%	4.0%	4.0%

附註：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國

產能*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
上海 12吋廠 (12吋)	27,000	24,750
北京廠(12吋)	81,000	81,000
天津廠(8吋)	36,000	36,000
晶圓代工生產月產能合計	234,000	231,750

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以 30 天作爲計算基礎。

- 二零一三年第四季的月產能由二零一三年第三季的 23 萬 1 仟 750 片 8 吋晶圓增加至 23 萬 4 仟片晶圓，主要由於上海 12 吋廠的產能擴充。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	二零一二年 季度比較	二零一二年 第四季度	二零一二年 年度比較
付運晶圓	601,602	653,090	-7.9%	608,372	-1.1%
產能利用率 ⁽¹⁾	87.4%	88.2%	-	90.5%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	季度比較	二零一二年 第四季度	年度比較
銷售成本	398,858	422,274	-5.5%	389,127	2.5%
折舊	113,289	126,433	-10.4%	112,290	0.9%
其他製造成本	284,327	294,374	-3.4%	276,367	2.9%
股權報酬	1,242	1,467	-15.3%	470	164.3%
毛利	92,939	111,982	-17.0%	96,767	-4.0%
毛利率	18.9%	21.0%	-	19.9%	-

- 二零一三年第四季的銷售成本由二零一三年第三季的 4 億 2 仟 2 佰 30 萬元下降 5.5% 至 3 億 9 仟 8 佰 90 萬元。
- 二零一三年第四季歸屬於銷售成本的折舊減少至 1 億 1 仟 3 佰 30 萬元，相比二零一三年第三季為 1 億 2 仟 6 佰 40 萬元，主要由於二零一三年第四季的晶圓付運量減少所致。
- 二零一三年第四季歸屬於銷售成本的其他製造成本減少至 2 億 8 仟 4 佰 30 萬元，相比二零一三年第三季為 2 億 9 仟 4 佰 40 萬元。
- 二零一三年第四季的毛利由二零一三年第三季的毛利 1 億 1 仟 2 佰萬元減少 17.0% 至 9 仟 2 佰 90 萬元。
- 二零一三年第四季的毛利率由二零一三年第三季的 21.0% 下降至 18.9%，主要由於本季的產品組合改變、較低的產能利用率及對客戶索賠提列較高撥備所致。

經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	季度比較	二零一二年 第四季度	年度比較
經營開支	84,840	63,447	33.7%	45,079	88.2%
研究及開發開支	46,256	37,564	23.1%	26,676	73.4%
一般及行政開支	36,610	24,718	48.1%	29,437	24.4%
銷售及市場推廣開支	8,385	9,324	-10.1%	8,629	-2.8%
其他經營收入	(6,411)	(8,159)	-21.4%	(19,663)	-67.4%

- 二零一三年第四季的研究及開發開支為 4 仟 6 佰 30 萬元，相比二零一三年第三季為 3 仟 7 佰 60 萬元，主要由於本季較多的研發活動產生相應的研發開支以及本季在研究發展合約上獲得政府支持的資金較上季減少 4 佰 30 萬元所致。
- 二零一三年第四季的一般及行政開支由二零一三年第三季的 2 仟 4 佰 70 萬元增加 48.1% 至 3 仟 6 佰 60 萬元，主要由於 1) 本季增加壞帳費用的認列及 2) 本季因雇員生產力增加而計提花紅所致。
- 二零一三年第三季的其他經營收入為 6 佰 40 萬元，相比二零一三年第二季為 8 佰 20 萬元，該變動主要為 1) 處置部分屬於本公司的上海生活園區資產所產生的收益減少及 2) 因喪失對燦芯半導體有限公司及其子公司的控制權，不對其合併而產生的利益。

其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	季度比較	二零一二年 第四季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	7,756	(4,681)	-	(2,591)	-
利息收入	2,206	1,394	58.2%	1,276	72.9%
財務費用	(5,789)	(8,673)	-33.3%	(10,449)	-44.6%
外幣匯兌收益或虧損	6,228	2,404	159.1%	4,434	40.5%
其他收益或虧損	4,607	(357)	-	2,044	125.4%
應佔聯營公司利潤	504	551	-8.5%	104	384.6%

- 其他收益或虧損的變動，主要由於 1) 上個季度因暑假期間來自學校的收入減少及 2) 上個季度對備供出售投資認列的減損損失，因後續收回成本而於本季迴轉。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度	季度比較	二零一二年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	138,721	136,725	1.5%	140,021	-0.9%

流動資金

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度
現金及銀行結餘	462,483	473,507
限制性現金	147,625	195,813
其他財務資產	240,311	2,574
貿易及其他應收賬款	379,361	396,108
預付經營開支	43,945	48,383
存貨	286,251	289,954
歸類為持作出售資產	3,265	210
流動資產總計	1,563,241	1,406,549
流動稅項負債	158	85
其他財務負債	-	10
承兌票據	-	14,895
預提負債	127,593	105,497
遞延政府補助	26,349	17,833
借貸	390,547	548,385
貿易及其他應付款項	393,890	402,827
流動負債總計	938,537	1,089,532
現金比率	0.5x	0.4x
速動比率	1.4x	1.0x
流動比率	1.7x	1.3x

資本結構

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度
現金及銀行結餘	462,483	473,507
限制性現金	147,625	195,813
長期票據即期部分	-	14,895
短期借款	390,547	548,385
長期借款	600,975	553,435
可轉換公司債	180,563	-
借款總計	1,172,085	1,101,820
權益	2,593,182	2,559,381
總債務股本比率 ⁽¹⁾	45.2%	43.1%

附注：

(1) 總債務股本比率為借款總計除以權益。借款總計包含短期和長期借款及可轉換公司債。

二零一三年第四季其他財務資產由二零一三年第三季的 2 億 60 萬元增加至 2 億 4 仟零 30 萬元，主要因為本公司於本季度發行面額 2 億元的零息可轉換公司債，並暫時將其投資於按公平價值於損益中列帳的短期投資。

現金流量概要

以千美元計	二零一三年 第四季度	二零一三年 第三季度
經營活動所得現金淨額	205,437	269,581
投資活動所用現金淨額	(269,147)	(213,133)
融資活動所得現金淨額	52,749	154,045
匯率變動的影響	(63)	59
現金變動淨額	(11,024)	210,552

資本開支概要

- 二零一三年第四季資本開支為 1 億 1 仟 4 佰 30 萬元。
- 二零一三年的資本開支有 6 億 5 仟 1 佰萬元用於晶圓廠運作，有 1 億 1 仟 9 佰萬元用於非晶圓廠運作，主要是雇員生活園區的建造，此為本公司留才計畫的一部分。
- 二零一四年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 8 億 8 仟萬元，其中約 5 億 7 仟萬元用於本公司的北京新計畫，該計畫由中芯國際出資 55%，由其他股東出資 45%。
- 另外，二零一四年我們已編列了用於非晶圓廠運作的資本開支約 1 億 1 仟萬元，主要是雇員生活園區的建造。

近期公佈

- ARM 與中芯國際針對移動與消費應用擴展 28 納米製程工藝 IP 合作(2014-02-09)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2014-01-28)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2014-01-28)
- 股東特別大會通告 (2014-01-28)
- 委任代表表格 - 於二零一四年二月十七日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 (2014-01-28)
- 通函 - 不獲豁免關連交易(1)大唐及 COUNTRY HILL 優先認購債券(2)建議授出額外特別授權,以便兌換優先債券時發行換股股份(3)股東特別大會通告 (2014-01-28)
- 董事會會議日期通知 (2014-01-27)
- 中芯國際開啓 28 納米新紀元 (2014-01-26)
- 雙界面金融 IC 卡芯片基於中芯國際 eEEPROM 平台獲國際 CC EAL4+認證 (2014-01-22)
- 中芯國際"芯肝寶貝計畫"已成功救助 18 名患兒 (2014-01-13)
- 延期寄發通函 (2014-01-13)
- 力旺電子與中芯國際聯手佈局技術發展 (2013-12-30)
- (1)不獲豁免關連交易及(2)大唐及 COUNTRY HILL 優先認購債券 (2013-12-18)
- (1)不獲豁免關連交易及(2)大唐及 COUNTRY HILL 行使優先認購權 (2013-11-08)
- 完成發行本金額 200,000,000 美元二零一八年到期零息可換股債券 (2013-11-07)
- 授出購股期權 (2013-11-04)
- (1)建議發行本金額 200,000,000 美元二零一八年到期零息可換股債券(2)大唐優先認購權及(3)COUNTRY HILL 優先認購權 (2013-10-25)
- 潛在不獲豁免關連交易大唐及 COUNTRY HILL 潛在行使優先認購權 (2013-10-24)
- 中芯國際截至二零一三年九月三十日止三個月未經審核業績公布 (2013-10-22)
- 董事名單與其角色和職能 (2013-10-22)
- 委任替任董事 (2013-10-22)
- 中芯國際成立 CVS3D IC 中心 (2013-10-21)
- 中芯國際推出差異化的 0.13 微米低功耗嵌入式工藝 (2013-10-15)
- 董事會會議日期通知 (2013-10-08)
- 採用中芯國際 eEEPROM 平台的銀行卡產品獲銀聯認證 (2013-10-08)
- 中芯國際 IP 研發中心採用華大九天 EDA 解決方案 (2013-10-04)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併損益及其他綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)
收入	491,797	534,256
銷售成本	(398,858)	(422,274)
毛利	92,939	111,982
研究及開發開支	(46,256)	(37,564)
一般及行政開支	(36,610)	(24,718)
銷售及市場推廣開支	(8,385)	(9,324)
其他經營收入	6,411	8,159
經營利潤	8,099	48,535
其他收入(開支)，淨額	7,756	(4,681)
除稅前利潤	15,855	43,854
所得稅開支	(170)	(914)
本期利潤	15,685	42,940
其他綜合收入		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	333	77
本期綜合收入總額	16,018	43,017
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	14,681	42,491
非控制權益	1,004	449
	15,685	42,940
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	15,014	42,568
非控制權益	1,004	449
	16,018	43,017
中芯國際應佔每股股份盈利，基本及攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利，基本及攤薄	0.02	0.07
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	32,102,304,565	32,083,651,959
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	33,692,855,386	32,354,552,218
比較公認準則計量而調節出非公認準則的財務計量⁽¹⁾		
非公認準則的收入	483,597	503,669
非公認準則的銷售成本	(390,879)	(392,407)
非公認準則的毛利率	19.2%	22.1%

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收入表(續)
(以千美元為單位，每股資料除外)

附註:

- (1) 中芯國際將非公認準則的收入、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率(此為非公認準則的財務計量)定義為，皆不包含來自武漢新芯晶圓轉單的收入、銷售成本及毛利率。中芯國際一併覆核了收入、銷貨成本及毛利率和非公認準則的財務計量，去了解、管理和評估其業務，以及去制定營運和財務方面的決策。本公司也相信這些補充資訊對投資者及分析人員用以評估公司在不包含來自武漢新芯晶圓轉單銷售額(並非產自公司的產品線產能)後的營運表現來說是有用的。中芯國際已於二零一三年三月作出公告，停止代武漢新芯經營管理在武漢的300mm晶圓廠，且於二零一三年第三季起正逐步結束來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。然而，把非公認準則的財務計量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認準則的財務計量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非公認準則的財務計量不會被其他公司用相同的方法計算，相對於其他公司在類似名稱的計量上，或許無法比較。根據上述提到的限制，對於遵照國際財務報告準則編制的收入、銷貨成本及毛利率，不應該僅考慮非公認準則的財務計量，或認為非公認準則的財務計量是可選擇的。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製的收入、銷售成本及毛利率(此為最直接可比較的財務計量)，調節至各項非公認準則的收入、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率。

	截至以下日期止三個月		
	二零一三年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)
收入	491,797	534,256	485,894
來自武漢新芯的收入	(8,200)	(30,587)	(48,510)
非公認準則的收入	<u>483,597</u>	<u>503,669</u>	<u>437,384</u>
銷售成本	(398,858)	(422,274)	(389,127)
來自武漢新芯的銷售成本	7,979	29,867	47,370
非公認準則的銷售成本	<u>(390,879)</u>	<u>(392,407)</u>	<u>(341,757)</u>
毛利率	18.9%	21.0%	19.9%
非公認準則的毛利率	<u>19.2%</u>	<u>22.1%</u>	<u>21.9%</u>

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	2,528,834	2,558,563
預付土地使用權	136,725	123,974
無形資產	215,265	227,380
於聯營公司的投資	29,200	23,758
遞延稅項資產	43,890	43,889
其他資產	6,237	36,969
非流動總資產	2,960,151	3,014,533
<i>流動資產</i>		
存貨	286,251	289,954
預付經營開支	43,945	48,383
貿易及其他應收款項	379,361	396,108
其他財務資產	240,311	2,574
受限制現金	147,625	195,813
現金及銀行結餘	462,483	473,507
	1,559,976	1,406,339
歸類為持作出售資產	3,265	210
流動總資產	1,563,241	1,406,549
總資產	4,523,392	4,421,082
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一三年十二月 三十一日及二零一三年九月三十日已發行 及流通股份分別為 32,112,307,101 股及 32,088,989,727 股。	12,845	12,836
股份溢價	4,089,846	4,088,854
儲備	74,940	56,993
累計虧絀	(1,693,859)	(1,708,540)
本公司擁有人應佔權益	2,483,772	2,450,143
非控制權益	109,410	109,238
總權益	2,593,182	2,559,381

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	600,975	553,435
可轉換公司債	180,563	-
遞延稅項負債	167	207
遞延政府資金	209,968	213,098
長期財務負債	-	5,429
非流動總負債	991,673	772,169
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	393,890	402,827
借貸	390,547	548,385
遞延政府資金	26,349	17,833
預提負債	127,593	105,497
承兌票據	-	14,895
其他財務負債	-	10
流動稅項負債	158	85
流動總負債	938,537	1,089,532
總負債	1,930,210	1,861,701
權益及負債合計	4,523,392	4,421,082

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	15,685	42,940
折舊及攤銷	138,721	136,725
應佔聯營公司利潤	(504)	(551)
營運資金的變動及其它	51,535	90,467
經營活動所得現金淨額	205,437	269,581
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(83,459)	(255,561)
對無形資產的付款	(6,517)	(9,414)
對土地使用權的付款	(14,641)	-
出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項	46,822	15,140
與投資活動有關的受限制現金變動	30,961	7,305
收購財務資產付款	(248,498)	(5,225)
出售財務資產所得款項	13,546	5,518
出售子公司股權所得款項	-	29,104
因喪失控制權導致之不合併子公司的現金變動	(6,799)	-
其他	(562)	-
投資活動所用現金淨額	(269,147)	(213,133)
融資活動:		
借款所得款項	108,343	434,170
償還借款	(236,959)	(388,671)
發生可轉換公司債所得款項	195,800	-
償還承兌票據	(15,000)	-
行使雇員認股權所得款項	565	546
來自非控股權益之款項	-	108,000
融資活動所得現金淨額	52,749	154,045
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(63)	59
現金及銀行結餘 (減少)增加淨額	(11,024)	210,552
現金及銀行結餘－期間開始	473,507	262,955
現金及銀行結餘－期間結束	462,483	473,507